



## 产品加工指南

覆铜板: SDI06K

半固化片: SDI06KB

高 Tg 无卤, 低介电常数材料



本产品使用指南依托于 IPC-4101 标准，并在该标准的基础上，根据产品特征的实际情况进行整理，使之更利于生益 SDI06K/SDI06KB 产品的使用。

无卤产品定义：根据 JPCA 标准的定义，将 Cl 含量 $\leq$ 900PPM、Br 含量 $\leq$ 900PPM、总卤素含量 $\leq$ 1500PPM 的阻燃型覆铜板称为无卤型覆铜板。

## 1. 储存条件

### 1.1 覆铜板

#### 1.1.1 存放方式

- 以原包装形式放在平台上或适宜的架上，避免重压，防止存放方式不妥而引起的板材形变。

#### 1.1.2 存放环境

- 板材宜存放在通风、干燥、室温的环境下，避免阳光直射、雨淋，避免腐蚀性气体的侵蚀（存放的环境直接影响板材的品质）。
- 双面板在此合适的环境下存放两年，单面板在此合适的环境下存放一年，其内部性能可以满足 IPC4101 标准要求。

#### 1.1.3 操作

- 需戴清洁手套小心地操作板材。碰撞、滑动等会损伤铜箔；裸手操作会污染铜箔面，这些缺陷都可能会对板材的使用造成不良的影响。

### 1.2 半固化片

#### 1.2.1 存放方式

- 以原包装形式水平存放，避免重压，防止存放方式不妥而引起的半固化片破损。
- 裁剪剩余的卷状半固化片仍需用保鲜膜密封包装好，放回原包装中托架上。

#### 1.2.2 存放环境

半固化片应密封包装存放在无紫外光照射的环境下，具体存放条件及储存期如下：

- 条件一：温度 $<23^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $<50\%$ ，贮存期为 3 个月；
- 条件二：温度 $<5^{\circ}\text{C}$ ，贮存期为 6 个月。

相对湿度对于半固化片品质影响最大，需加以关注（天气潮湿时要作相应的除湿处理）。粘结片打开包装后，建议在 3 天内使用完毕。

#### 1.2.3 使用注意事项

- 半固化片从冷库取出，在打开包装之前必须经过回温过程，回温时间为 4 个小时以上（视乎具体存放条件），待和环境温度相同后打开包装。
- 已经开成片状的 PP 需存放在条件一或条件二的环境下，并尽快用完，超过 3 天，必须复检其指标合格后再



使用。

- 卷状 PP 打开包装后，对于剩余的卷状尾数部分，要求进行原包装程度的密封包装，并存放在条件一或条件二中。
- 如有 IQC 检验计划，按照 IPC-4101 标准，粘结片应在收货后尽快测试（不超过 3 天）。
- 如对片状 PP 使用前进行抽湿，抽湿柜的设定建议  $<20^{\circ}\text{C}$ ，湿度 40% 左右，波动的上限不要超过 50%。

## 2. PCB 加工建议

### 2.1 开料

- 推荐选用锯床开料方式，其次使用剪床，注意辊刀开料可能会引发板边分层问题；避免因刀具磨损、间隙不适导致板边分层问题。

### 2.2 芯板烘烤

- 可根据实际使用情况选择对芯板进行烘烤；如采用开料后烘烤，建议开料后先过一遍高压水洗后再烘烤，避免剪切过程中产生的树脂粉末引入到板面，引起蚀刻不良问题。
- 烘板条件： $180^{\circ}\text{C}/2 \sim 4\text{h}$ ，注意板材不能与热源直接接触。

### 2.3 内层棕化/黑化

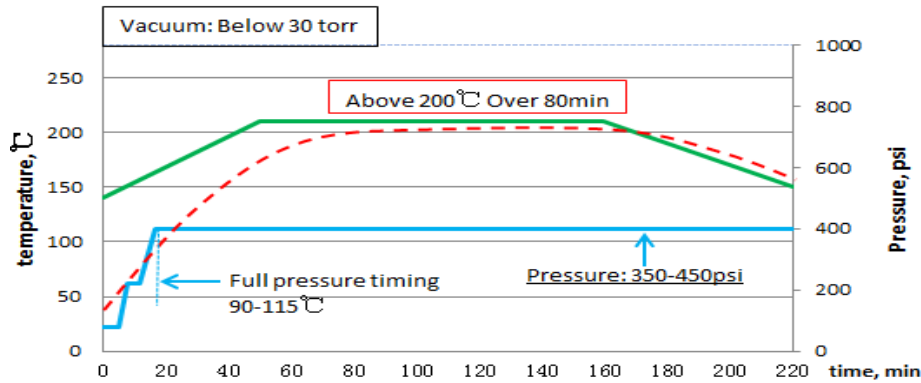
- SDI06K 适用于绝大部分 PCB 棕化/黑化工艺。
- 棕化后烘板条件： $120^{\circ}\text{C}/2\text{h}$ ，注意板材不能与热源直接接触。

### 2.4 叠料

- 叠料的过程保证粘结片的叠放顺序一致，避免反转或者翻转的动作，避免引起翘曲变形问题。

### 2.5 层压

- 多层板层压时建议升温速率为  $2.0\text{-}4.0^{\circ}\text{C}/\text{min}$ （材料温度在  $80\sim 140^{\circ}\text{C}$  的区域内；超薄布 1017/1010PP 建议压合温升  $3.0\text{-}4.0^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ）。
- 层压的高压推荐 350-450PSI（油压机），具体的高压需要根据板材的结构特点（半固化片数量和填胶区域的大小）来进行调节。
- 外层料温推荐在  $90\text{-}115^{\circ}\text{C}$  时转高压。
- 固化条件： $200^{\circ}\text{C}$ ， $>80\text{min}$ 。
- 如多层板中有使用到绝缘板或者单面板，需要对绝缘板或者单面板进行粗化处理后再进行使用，避免因绝缘板太光滑引起的结合力不足问题，或者使用双面板蚀刻成单面板或者绝缘板来生产。



## 2.6 机械钻孔

- 最好能使用新钻头加工。
- 叠层厚度建议不多于 2 块/叠 (按板厚 0.8mm/块计算)。
- 建议钻孔孔限在 500-1000 孔范围。
- 钻孔的进给量需要比加工普通 FR-4 材料下降 10-25%。
- 钻孔后烘板条件：180°C/4h，注意板材不能与热源直接接触。

## 2.7 镭射钻孔

使用常规中高 Tg 无卤基材镭射钻孔加工参数即可。

## 2.7 Desmear

SDI06K 建议采用 Plasma+化学除胶方式。除胶温度和时间需要在批量前测试确定。溶胀或 Desmear 过度可能会引起树脂收缩、孔粗问题，具体条件请和生益科技服务团队联系。

## 2.8 阻焊油墨

- 采用插架烘烤时，如板材插架时受到挤压或变形，烘烤后会出现翘曲问题。
- 不推荐进行绿油返洗，可能会出现白点现象。

## 2.9 喷锡

- 适合于无铅喷锡工艺；

## 2.10 外形加工

不建议啤板(Punching)加工。但是对于 unit 较小厚度较薄的板材，很多 PCB 厂仍会选择啤板的方式加工，建议量产前试验合适加工参数及设备控制

## 2.11 包装

- 建议在包装前进行烘板，条件为 125°C/4~8h，以免潮气造成耐热性下降问题。
- 如 PCB 板需要存放较长时间才使用，建议铝箔真空包装。

# 3. 焊接工艺



### 3.1 包装有效期

- 推荐 3 个月内；
- 元件组装前最好 125°C/4~6h 烘烤后再使用。

### 3.2 回流焊接参数建议：

- 适合于常规无铅回流焊接加工条件。

### 3.3 手工焊接参数建议：

对于独立焊盘或者边缘焊盘：

- 焊接温度为 350 ~ 380°C ( 使用温控烙铁 )
- 单个焊点的焊接时间：3 秒以内

## 4. 结束语

本使用指南仅供参考！在使用生益 SDI06K/SDI06KB 产品期间，如有任何疑问及建议，请随时联系生益，生益将给您提供快捷有效的技术服务。

广东生益科技股份有限公司

2022 年 11 月